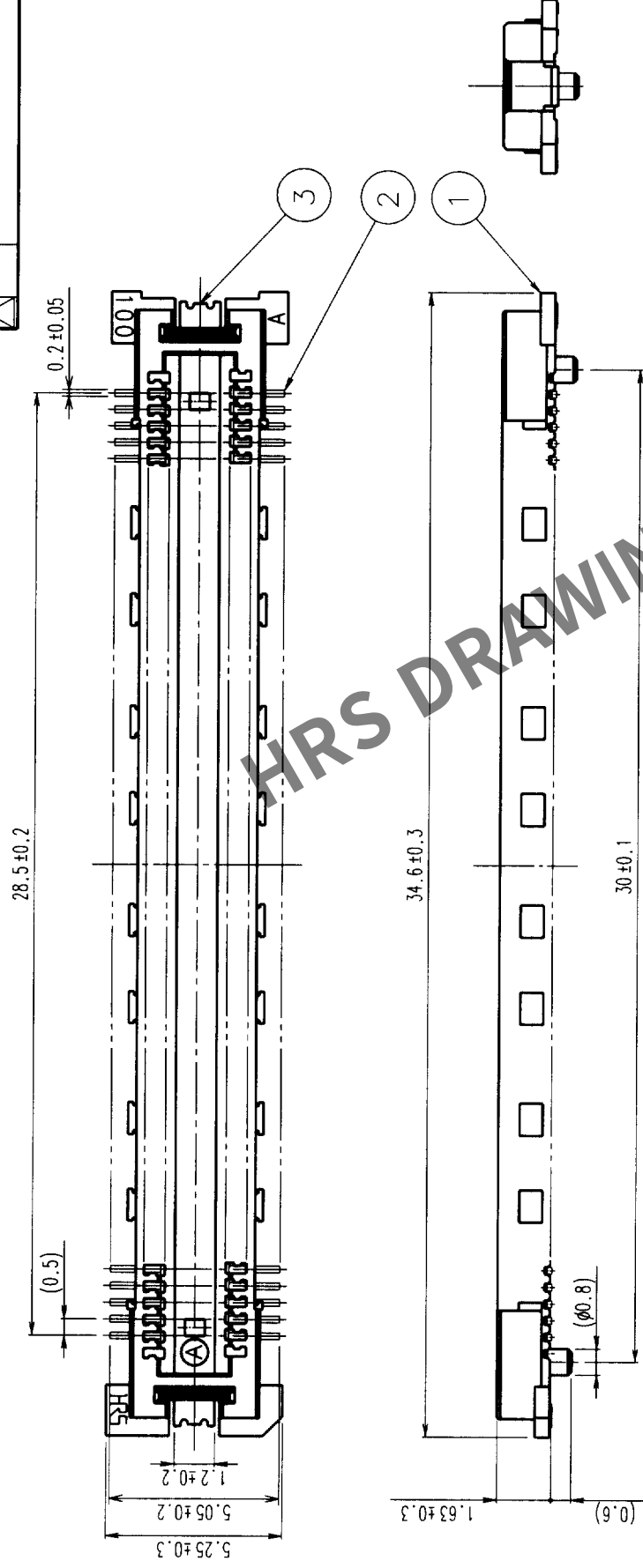
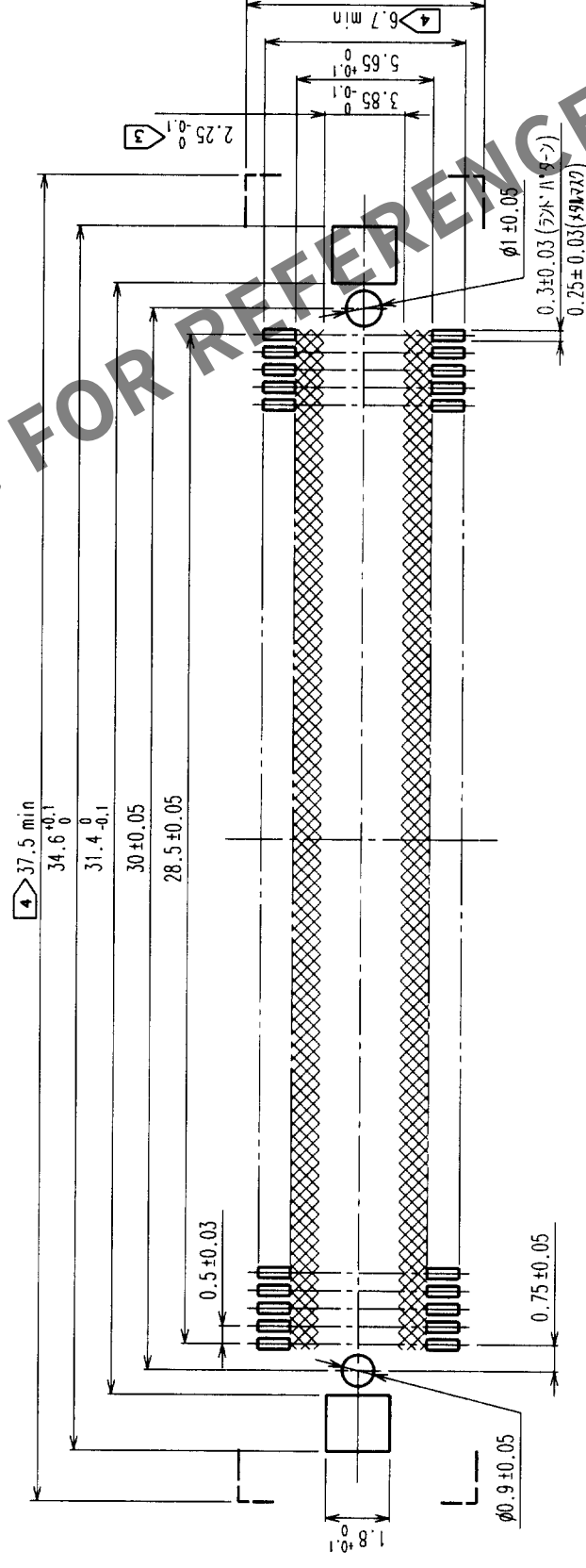


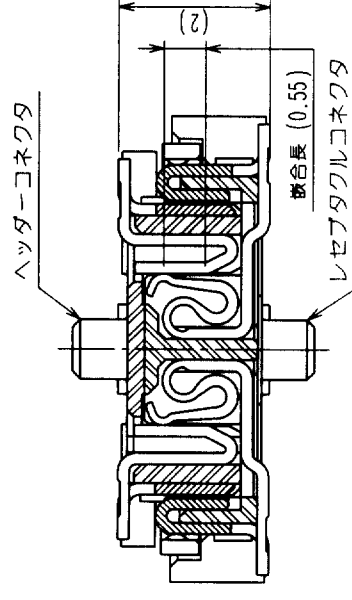
△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・



図法ワンパターンイラスト



信号部断面図 (10:1)



2	銅合金	接合部：ニッケル下地+金めっき $0.1\mu\text{m}$ 結核部：ニッケル下地+金めっき+フッラシユ
---	-----	---

1	LCP樹脂	ページ	UL94V-0	3	りん青銅	すずめっき	
品番	材質	処理	備考	品番	材質	処理	備考
備考	REMARKS						

旧製品コード CODE NO. (OLD)	 尺 1 寸 1 mm	図番 DRAWING NO. ADC3-152102-01	 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品名 PART NO. FX11LA-116P-SV (21)				製品コード CODE NO. CL573-0044-7-21		1	2
				DRAWN  松川	DESIGNED  松川	CHECKED  石田	APPROVED  17	RELEASES			

- 注 1 本製品のSMTリードの平坦度は0.1maxとなります。
- 2 本製品には基板実装上の優性はありません。
- ③ SMTランド内側の××××の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド端からハターンが出ないようご注意ください。
- ④ ③の範囲内には、本製品以外の部品を搭載しないでください。相手コネクタとの嵌合ができません。
- 5 本製品の梱包形態は、次頁の通りエンボスキャリア形テープ・ビンクとなります。

TO	PCK			
----	-----	--	--	--

